

行业简讯

二〇二六年第八期

8 月 18 日发

协会办公室编印

(总第 453 期)

(行业内交流)

内 容 提 要

综合信息

- ☆ 2026 年上半年规上电子信息制造业营业收入同比增长 18.5%

协会动态

- ☆ 第十四届 (2026 年) 中国电子专用设备工业协会半导体设备年会议程

会员动态

- ☆ 盛美上海: 拓展 Ultra C Tahoe 为多工艺湿法处理平台
- ☆ 奥特维: 大宽幅量产蒸发镀膜设备交付钙钛矿领军企业
- ☆ 华海清科: 首台 6 英寸集成量测装备出机
- ☆ 中微公司: 2026 年上半年预计营收同比增长 34.89%
- ☆ 日联科技: 预计 2026 年上半年营收同比增长 55.30%
- ☆ 苏试试验: 2026 年上半年主营业务收入同比增长 8.19%
- ☆ 富创精密: 2026 年上半年营业收入同比增长 21.83%到 45.03%

行业动态

- ☆ 第十四届半导体设备与核心部件及材料展示会 8 月 31 日在无锡举办

知识产权委员会动态

- ☆ 北方华创：构筑核心技术壁垒，领跑中国半导体设备创新

市场动态与预测

- ☆ SEMI：2028 年全球半导体设备销售额预达 2295 亿美元
- ☆ SEMI 与 GNC 联合发布半导体玻璃核心基板市场与发展趋势最新报告

综合信息

2026 年上半年规上电子信息制造业营业收入同比增长 18.5%

2026 年上半年，我国电子信息制造业生产继续加快，出口稳定向好，效益保持增势，投资平稳增长，行业整体发展态势良好。

一、生产继续加快

上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 14.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 9.4 个和高 1.5 个百分点。

主要产品中，工业机器人产量 53.8 万套，同比增长 28.0%；新能源汽车产量 739.9 万辆，同比增长 6.0%；集成电路产量 2798 亿块，同比增长 23.1%。

二、出口稳定向好

上半年，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 7.8%。

据海关统计，上半年，我国出口电视机 5023 万台，同比增长 3.1%；出口手机 3.25 亿台，同比下降 4.3%；出口集成电路 1794 亿个，同比增长 7%。

三、效益保持增势

上半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入 9.41 万亿元，同比增长 18.5%；营业成本 7.98 万亿元，同比增长 15.4%；实现利润总额 5777 亿元，同比增长 96.9%。

四、投资平稳增长

上半年，电子信息制造业固定资产投资同比增长 6.5%，较 1—5 月份回落 0.2 个百分点，比同期工业投资增速高 7.6 个百分点。

五、中部地区收入增长较快

上半年，规模以上电子信息制造业

东部地区实现营业收入 64973 亿元，同比增长 13.2%；

中部地区实现营业收入 18639 亿元，同比增长 44.8%；

西部地区实现营业收入 10025 亿元，同比增长 14.9%；

东北地区实现营业收入 441 亿元，同比增长 1.4%。

（来自：工业和信息化部运行监测协调局）

协会动态

第十四届(2026 年)中国电子专用设备工业协会半导体设备年会议程

开幕式

时间：9 月 1 日 9:30-9:50

地点：无锡太湖国际博览中心（无锡市滨湖区太湖新城清舒道 88 号）A4 馆

主旨报告

时间：9 月 1 日 9:50-11:55 地点：无锡太湖国际博览中心 A4 馆

主持人：王志越 中国电子专用设备工业协会秘书长

时间	报告题目/演讲人
09:50-10:15	量子科技体系和产业体系建设 陆 军 中国电子科技集团公司首席科学家
10:15-10:40	AI 引领半导体装备新未来：北方华创的发展战略与前瞻探索 董博宇 中国电子专用设备工业协会理事长 北方华创科技集团股份有限公司总裁
10:40-11:05	三维闪存架构工艺设备的协同创新与发展 霍宗亮 长江存储科技有限责任公司首席科学家
11:05-11:30	主要国家和地区半导体技术发展战略和态势 史冬梅 国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心 二级研究员
11:30-11:55	构建半导体具身智能设备开发范式平台，实现合作共赢 黎家俨 合肥晶合集成电路股份有限公司 研发 AI 总负责人

时间：9 月 1 日 13:30-17:00 地点：无锡太湖国际博览中心 A4 馆

主持人：张 帆 中国电子专用设备工业协会副理事长

日联科技集团股份有限公司研究院院长

时间	报告题目/演讲人
13:30-13:55	芯片制造量检测设备现状与国产化进程 李晋湘 中国电子专用设备工业协会副秘书长 工信部电子科技专家委员会委员
13:55-14:20	坚持长期主义，以技术创新突破半导体设备行业内卷 王燕清 无锡先导智能装备股份有限公司董事长

14:20-14:45	从“看见”到“预见”——电子束量检测设备与 OPC 的协同演进与未来趋势 雒晓军 东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司高级副总裁
14:45-15:00	企业新品发布专场 江苏微导纳米科技股份有限公司：iTomic® MeT 系列原子沉积系统、iTronix® MTP 系列等离子体增强化学气相沉积系统发布 江苏京创先进电子科技有限公司：JTA-9612 全自动减薄抛光贴撕膜一体设备发布 江苏快克芯装备科技有限公司：先进封装热压键合设备（TCB）发布
15:00-15:25	AI 浪潮重塑半导体格局：先进工艺革新与盛美差异化创新之路 王 希 盛美半导体设备（上海）股份有限公司市场销售资深副总裁
15:25-15:50	面向 12 英寸先进集成电路制造的无图形颗粒检测设备的开发与应用 初新堂 京城中安半导体设备（北京）有限公司市场副总
15:50-16:15	2026 上半年中国半导体设备行业经济定性分析 王志越 中国电子专用设备工业协会秘书长
16:15-17:00	董事长圆桌对话 主持人：张 卫 上海复旦微电子集团股份有限公司董事长兼总经理 嘉 宾：董博宇 中国电子专用设备工业协会理事长 北方华创科技集团股份有限公司总裁 尹志尧 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事长兼总经理 郑广文 沈阳富创精密设备股份有限公司董事长兼总经理 蔡 琳 北京华峰测控技术股份有限公司总经理 刘 骏 日联科技股份有限公司董事长 于大全 厦门云天半导体科技有限公司董事长兼总经理 郑志成 合肥晶合集成电路股份有限公司联席总经理

刻蚀技术、制程及设备专题论坛

时间：9月1日 9:30-12:00 地点：无锡太湖国际博览中心A6馆

主持人：丛 海 中微半导体设备（上海）股份有限公司资深副总裁

时间	主题报告/演讲人
9:30-9:50	精进刻蚀技艺，决胜三维工艺 王红超 中微半导体设备（上海）股份有限公司商务拓展与技术市场副总监
9:50-10:20	多平台刻蚀能力建设与量产实践 陈颖儒 重庆芯联微电子有限公司 刻蚀工程处副总监

10:20-10:40	邑文科技刻蚀技术在三代半硅光化合物半导体领域的应用 邓家亮 无锡邑文微电子科技股份有限公司 销售部总经理
10:40-11:00	离子束修平在表面超平坦化与梯度刻蚀的应用 李自超 江苏鲁汶仪器股份有限公司 技术专家
11:00-11:20	面向高端硅光子芯片制造的前沿尖端解决方案 陈才干 泛林集团 工艺经理
11:25-12:00	圆桌对话 主持人： 李海明 重庆芯联微电子有限公司资深副总经理 嘉 宾： 丛 海 中微半导体设备（上海）股份有限公司 资深副总裁 卢合强 华海清科股份有限公司 离子注入工艺技术总监 董 溯 江苏鲁汶仪器股份有限公司 副总经理 王 旭 御微半导体 地区部总经理 任连娟 应用材料（中国）有限公司 高级总监

薄膜沉积技术、制程及设备专题论坛

时间：9月1日 13:30-17:10 地点：无锡太湖国际博览中心A6馆

主持人：于大洋 北京诺华资本投资管理有限公司 总经理

时间	主题报告/演讲人
13:30-13:50	先进逻辑与存储器件半导体装备应用与挑战 许 灿 中微半导体设备(上海)股份有限公司金属沉积产品部总经理
13:50-14:10	集成电路制造中金属化工艺装备的应用与挑战 张钦彤 北京北方华创微电子装备有限公司 MDP事业单元CTO
14:10-14:30	超保形性介电材料原子层沉积工艺 - 助力国产三维芯片技术开发和应用 刘武平 拓荆科技（上海）有限公司副总裁
14:30-14:50	面向晶圆制造的前道关键装备：从原子层沉积到离子注入的协同创新 张 丛 青岛思锐智能科技股份有限公司首席技术官
14:50-15:10	面向亚3纳米节点的集成电路原子级制造技术矩阵 金一诺 盛美半导体设备（上海）股份有限公司工艺副总裁
15:10-15:30	High-k材料在逻辑器件的应用 符腾飞 江苏微导纳米科技股份有限公司专家工程师
15:30-15:50	半导体薄膜设备国产化新进展 张 汀 上海积塔半导体有限公司总经理助理

15:50-16:10	集成电路物理气相沉积设备研发与产业化 程厚义 合肥致真精密设备有限公司董事长/首席技术官
16:10-16:30	算力换产能—AI驱动半导体设备与制造的效能革命 吴启明 合肥晶合集成电路股份有限公司资深处长
16:30-17:10	圆桌对话 主持人： 于大洋 北京诺华资本投资管理有限公司 总经理 嘉 宾： 蒋剑勇 宁波江丰电子材料股份有限公司半导体事业部总经理 李 杰 埃克斯控股（北京）有限公司董事长 汪穹宇 安徽安德科铭半导体科技股份有限公司董事长/总经理 邓 斌 北方华创微电子MDP事业单元总经理

量测技术及设备专题论坛

时间：9月1日 13:25-17:00 地点：无锡太湖国际博览中心B4馆

主持人：季宗亮 季华资本创始人、启泰沣华创始人

时间	主题报告/演讲人
13:25-13:30	欢迎致辞 黄安君 华虹半导体（无锡）有限公司副总裁、无锡半导体行业协会秘书长
13:30-13:50	晶圆与裸片级光学故障定位难点及技术路线图 潘福杰 赛美康半导体（无锡）有限公司董事长兼首席执行官
13:50-14:10	用于缺陷评价的扫描电镜倾斜观察技术 袁雍煜 日立高新技术（上海）国际贸易有限公司高级工程师
14:10-14:30	从“智能检测”向“智能决策”：AI赋能量检测设备的全新可能 张雪娜 深圳市埃芯半导体科技有限公司董事长
14:30-14:50	化合物半导体全工艺流程的光学量检测方案 高 昆 中电科风华信息装备股份有限公司研发总监
14:50-15:10	题目待定 东精精密设备（上海）有限公司
15:10-15:30	TGV在线快速光学量检测解决方案 张朝前 北京电子量检测装备有限责任公司研发总监
15:30-15:50	先进半导体制造中的量测需求与技术挑战 曾安生 御微半导体技术有限公司市场总监

15:50-16:10	AI及先进封装浪潮下重塑存储BI测试新范式：挑战、创新与量产突围 王建伟 上海启泰沣华半导体科技有限公司研发副总经理
16:10-17:00	圆桌对话 主持人：季宗亮 季华资本创始人、启泰沣华创始人 嘉 宾：王 帆 御微半导体技术有限公司总裁 温任华 魅杰董事长 张 峰 江苏芯势科技有限公司 董事长 张雪娜 深圳市埃芯半导体科技有限公司董事长

先进制程清洗技术及设备专题论坛

时间： 9月1日 9:30-12:00 地点：无锡太湖国际博览中心B4馆

主持人：张晓燕 盛美半导体设备（上海）股份有限公司副总裁

时间	主题报告/演讲人
9:30-9:55	先进湿法清洗工艺技术挑战及发展方向 王文军 盛美半导体设备（上海）股份有限公司工艺副总裁
9:55-10:20	面向光电共封装应用的键合技术及演进趋势 戴风伟 华进半导体先导技术研发中心有限公司资深研发总监
10:20-10:45	先进清洗制程的挑战与ESG贡献 李瑞平 扬帆半导体科技(苏州)有限公司首席技术长
10:45-11:10	国产湿法设备的技术跨越与先进制程挑战 雷光宇 中国电子科技集团公司第四十五研究所湿法工艺主管
11:10-11:35	半导体装备零部件精密清洗与微污染控制 张正伟 安徽富乐德科技发展股份有限公司技术总监
11:35-12:00	先进制程用高纯PFA的制备与应用 林榜佳 巨化集团有限公司可熔氟树脂产品经理

人工智能与电子制造设备发展专题论坛

时间：9月1日 9:30-11:50 地点：无锡君来世尊酒店梅花厅

主持人：叶乐志 博士 中国电子专用设备工业协会副秘书长

时间	主题报告/演讲人
9:30-9:50	多Agent虚拟制造赋能接近式光刻——从计算光刻到智能装备的范式变革 曹子峥 浙江大学长聘教授/求是特聘教授

9:50-10:10	AI赋能半导体装备高质量发展 巩小亮 中电科电子装备集团有限公司技术总体部主任
10:10-10:30	面向AI芯片的先进封装FOPLP与电镀技术的机遇与挑战 贾照伟 盛美半导体设备（上海）股份有限公司工艺资深副总裁
10:30-10:50	AI-Native智能装备：重塑半导体研发与制造新范式 刘 斌 埃克斯控股（北京）有限公司首席技术官,博士
10:50-11:10	微环控部件与半导体整机协同机制探讨 李小平 武汉微环控技术有限公司创始人
11:10-11:30	集成电路产业人才需求报告及上海电机学院人才培养现状 刘 娜 上海电机学院教授、产业发展研究中心集成电路产业负责人
11:30-11:50	IBM 如何以混合云与 AI 算力解锁半导体“智造”新范式 庞文峥 IBM 大中华区存储产品经理

先进键合技术、制程及设备专题论坛

时间：8月31日 9:30-12:00 地点：无锡太湖国际博览中心B6馆

主持人：易海兰 张江实验室专家项目经理

时间	主题报告/演讲人
9:30-9:50	先进封装设备赋能异构集成新生态 耿 波 北方华创科技集团股份有限公司POP事业单元总经理
9:50-10:10	晶圆键合技术驱动三维集成发展 郭万里 拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司总经理
10:10-10:30	从装备到工艺：先进键合技术赋能异质集成规模化落地 母凤文 青禾晶元半导体科技（集团）有限责任公司创始人兼董事长
10:30-10:50	Hybrid Bonding: Enabling Tomorrow's Semiconductor Architectures Dr. Bernd Dielacher , Business development director, EV Group
10:50-11:10	易卜COORS®-V硅桥先进封装技术对键合技术的要求 黎 明 上海易卜半导体有限公司研发副总
11:10-11:30	芯堆叠·键未来：先进封装中键合与解键合的核心技术突破 王茂林 博纳半导体设备（浙江）有限公司工艺研发总监
11:30-11:50	三维集成-后摩尔时代芯片新趋势 杨列勇 物元半导体技术（青岛）有限公司联合创始人和首席科学家

会议具体议程以当日实际议程安排为准，详情请与会务组联系（甘风华 15821588261）

会员动态

盛美上海：拓展 Ultra C Tahoe 为多工艺湿法处理平台

8 月 7 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（简称“盛美上海”）宣布其 Ultra C Tahoe 拓展为多工艺湿法处理平台，新增多项先进湿法工艺应用，可支持逻辑和存储器件制造中的更广泛需求。目前，该平台已获多家主流半导体制造商采用，Tahoe Recycle 控挡片再生工艺已进入客户端量产，验证了其在先进制造中的量产能力、多功能性及拓展潜力。

平台的新工艺应用和优势

更广泛的工艺应用：新增槽式氮气鼓泡技术，支持氮化硅均匀凹槽刻蚀、多晶硅刻蚀与回刻、钨凹槽处理以及锗硅凹槽刻蚀等先进湿法工艺。

更高效的控挡片再生：控挡片是用于监控制造设备状态和工艺稳定性的晶圆。应用于先进工艺控挡片再生工艺的 Tahoe Recycle 可支持薄膜和残留物去除、清洗及干燥等湿法处理环节，将原本分散的工序整合至同一平台完成；且对双面覆膜及厚膜晶圆具有更强的膜层去除能力，可显著提高再生后晶圆的洁净度和整体工艺效率。

卓越的颗粒控制能力：在 26 纳米颗粒测试中实现了平均颗粒数小于 6 个，表面金属残留小于 1×10^9 atoms/cm²。

显著的环保与成本优势：硫酸消耗量可降低高达 75%，从而降低大批量制造成本，支持可持续发展及 ESG 目标。

（来自：盛美上海）

奥特维：大宽幅量产蒸发镀膜设备交付钙钛矿领军企业

7 月 23 日，据无锡奥特维科技股份有限公司（简称：“奥特维”或“公司”）官微消息，近日，奥特维自主研发的首台大宽幅量产型钙钛矿蒸发镀膜设备正式发货，交付国内钙钛矿领军企业。公司表示，本次交付的百兆瓦级大幅宽量产型蒸发镀膜设备，实现公司钙钛矿真空装备产品的规模化落地应用。

（来自：每日经济新闻）

华海清科：首台 6 英寸集成量测装备出机

8 月 6 日，华海清科股份有限公司（简称“华海清科”）6 英寸集成量测装备正式出机，发往国内光学硅材料领军企业。

随着半导体 6 英寸特色工艺产线持续扩产，新材料、新应用加速导入，传统离线量测反馈滞后、覆盖率低等短板日益凸显，难以满足高一致性、高良率的制造需求。

针对这一痛点，华海清科推出 6 英寸集成量测装备，将其直接嵌入 CMP 工艺回路，在抛光前后即时量测，并将数据实时反馈至控制系统。该装备搭载 SAPC（Smart Advanced Process Control）系统，以闭环反馈控制方式实时调整抛光时间与各区域抛光压力，显著提升晶圆片内及片间均匀性；量测全程无需离线转运，与机台现有终点检测系统深度融合，动态补偿工艺漂移与波动，进一步提升晶圆间与批次间的一致性。该装备可实时捕获制程偏移，减少返工与报废，有效提升装备综合效率与整体良率，性能达到国际先进水平，并在国内首次实现了 6 英寸集成式量测装备与 CMP 装备的一体化集成。

（来自：华海清科）

中微公司：2026 年上半年预计营收同比增长 34.89%

8 月 4 日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）发布 2026 年半年度业绩预告：

- 1、公司预计 2026 年半年度营业收入约 66.91 亿元，同比增长约 34.89%。
- 2、公司预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 27 亿元到 29 亿元，同比增加 282.48%到 310.81%。
- 3、公司预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 10 亿元到 12 亿元，同比增加 85.61%到 122.73%。
- 4、2026 年上半年公司研发投入约 20.42 亿元，同比增长约 36.89%，2026 年上半年研发投入占公司营业收入比例约为 30.52%。
- 5、截至 2026 年 6 月底，公司累计已有超过 8800 个反应台在国内外 220 余条生产线实现量产。

（来自：中微公司）

日联科技：预计 2026 年上半年营收同比增长 55.30%

7 月 17 日，日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布 2026 年半年度业绩预告：1、公司预计 2026 年上半年实现营业收入约 7.15 亿元，同比增加约 55.30%；2、预计 2026 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润约 1.28 亿元，同比增加约 54.60%。3、预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 1.09 亿元，同比增加约 82.71%。

公司本期业绩增长主要原因是下游集成电路、高端电子制造等领域景气度高，市场需求旺盛，公司持续加大研发投入及全球营销网络建设，综合竞争力进一步提高。同时，公司通过投资并购积极打造检测平台化能力，收并购的并表公司为公司业绩增长产生一定贡献。

（来自：日联科技）

苏试试验：2026 年上半年主营业务收入同比增长 8.19%

7 月 24 日，苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称：“公司”)发布 2026 年半年报。

报告期内，公司主营业务收入 10.30 亿元，同比增长 8.93%。其中：试验设备收入 2.93 亿元，同比下降 5.30%；环境与可靠性试验服务收入 5.65 亿元，同比增长 16%；集成电路验证与分析服务收入 1.71 亿元，同比增长 10.61%。

归属于上市公司股东的净利润 1.29 亿元，同比增长 10.37%。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1.27 亿元，同比增长 11.06%。

（来自：苏试试验）

富创精密：2026 年上半年营业收入同比增长 21.83%~45.03%

7 月 20 日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称：“富创精密”或“公司”）发布 2026 年半年度业绩预告的自愿性披露公告。

1、预计 2026 年半年度实现营业收入 21 亿元到 25 亿元，同比增长 21.83%到 45.03%。

2、预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1.2 亿元 到 1.5 亿元，同比增长 877.49%到 1121.86%。

（来自：富创精密）

行业动态

第十四届半导体设备与核心部件及材料展示会 8 月 31 日在无锡召开

第十四届半导体设备与核心部件及材料展示会于 8 月 31 日~9 月 2 日在无锡太湖国际博览中心（无锡市滨湖区太湖新城清舒道 88 号）召开。展示会有 1394 家半导体设备、部件、材料制造商和高校参展，展区面积达 7 万平米。展位图可登录协会网站查看。

展示会联系人：黄 刚（13917571770）微信同号 甘风华（15821588261）微信同号

知识产权委员会动态

北方华创：构筑核心技术壁垒，领跑中国半导体设备创新

近年来，在全球半导体产业链深度重构的背景下，知识产权已成为科技企业构建核心竞争壁垒、制胜全球市场的关键利器。北方华创科技股份有限公司（简称：“北方华创”或“公司”）将知识产权深度嵌入研发、生产与全球化经营，走出了一条高质量知识产权发展之路。

一、构建知识产权立体防护网，筑牢高质量发展根基

截至最新年报，北方华创共申请专利超 11300 项，其中授权超 6500 项。公司建成从技术方案论证、专利挖掘布局到授权维护的完整流程闭环。在商标布局方面，公司围绕核心品牌及海外市场统筹注册，共注册国内外商标 100 余枚。常态化开展商标监测预警，通过异议前置等风控手段精准拦截混淆性商标注册，稳固企业商标专用权，为企业合规经营与市场拓展提供有力支撑。

二、严控知识产权质量，锻造竞争硬实力

北方华创建立了一整套知识产权质量控制体系，通过高标准内部审核机制严格把控专利撰写、审查答复、权利维护各环节质量，确保专利成果的“含金量”。在万余件专利申请中，发明专利占比超 80%，专利授权率持续保持在 80%以上。积极推进海外专利布局，海外专利占比超 20%，构筑起海外市场的坚实法律屏障。凭借卓越创新质量，公司连续多年荣获中国专利银奖、优秀奖，并获评北京市首批专利示范企业及国家知识产权示范企业等荣誉称号。

三、深度融入集成产品开发（IPD）体系，构建产品全生命周期护盾。

北方华创将知识产权全面融入 IPD 体系，从立项、研发到上市实施全流程护航。为推动知识产权与业务的深度融合，公司在各业务部门创新设立知识产权业务伙伴岗位，扎根研发一线，兼具法律与技术背景，将知识产权服务直接输送到业务最前端，护航研发项目的高效推进。

（来自：北方华创）

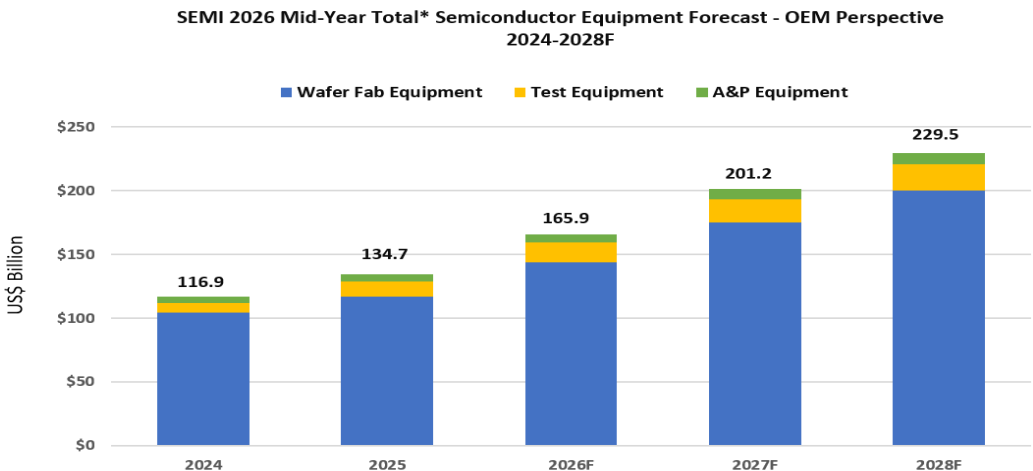
市场动态与预测

SEMI：2028 年全球半导体设备销售额预达 2295 亿美元

美国加州时间 2026 年 7 月 14 日，SEMI 在发布《年中总半导体设备市场预测报告》(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective) 中指出，预测 2026 年全球半导体制造设备 (OEM) 总销售额将创下 1659 亿美元的历史新高，同比增长 23.2%。增长势头预计将持续至 2028 年，总设备销售额有望达到创纪录的 2295 亿美元，实现连续五年增长，AI 驱动的需求正在重塑半导体制造投资格局。

这一乐观展望反映了 AI 基础设施投资的加速，以及支持更高计算密度、高带宽存储 (HBM) 相关投资和日益复杂的器件架构所需的前沿逻辑、先进存储和后端技术投资的增加。

半导体设备销售额（按细分市场划分）



Source: SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS), July 2026

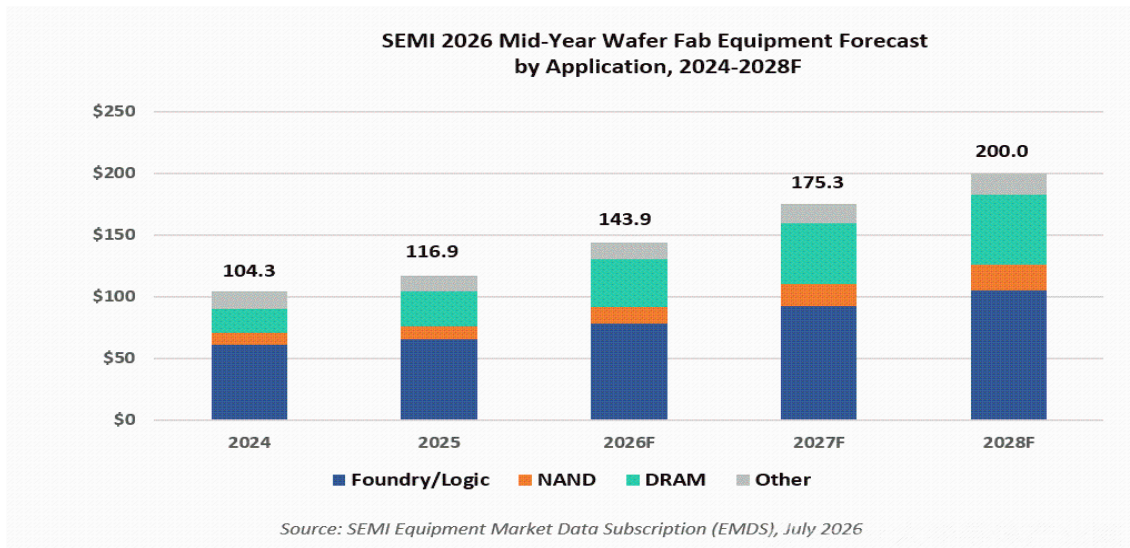
*Total equipment includes new wafer fab, test, assembly, and packaging, but does not include wafer manufacturing equipment.

自去年创下 1169 亿美元销售额纪录后，晶圆厂设备 (WFE) 领域（包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩膜/光罩设备）预计 2026 年将增长 23.1%至 1439 亿美元。这较 SEMI 2025 年末预测大幅上调，反映了先进存储（尤其是 HBM 相关 DRAM 技术）和前沿逻辑应用投资的增强。WFE 细分销售额预计 2027 年再增长 21.8%，2028 年增长 14.1%，突破 2000 亿美元大关，因为制造商正在加速产能扩张和技术迁移以满足 AI 相关工作负载需求。

AI 相关半导体需求也在推动后端设备领域市场扩张。2025 年激增 55.3%后，半导体测试设备销售额预计 2026 年将增长 31%至 153 亿美元，较 SEMI 2025 年末预测显著上调。封

装设备销售额 2025 年增长 20.8%，预计 2026 年将增长 9.6%至 67 亿美元，与此前预测基本一致。增长预计将持续至 2028 年，测试设备将达到 208 亿美元，封装设备将达到 86 亿美元，这得益于器件复杂度提升、先进异构封装采用率提高，以及 AI 和 HBM 器件对性能和可靠性更严格的要求。

WFE 销售额（按应用划分）



用于 Foundry 和 Logic 应用的 WFE 销售额 2026 年预计同比增长 18.9%至 780 亿美元，这得益于 AI 加速器、高性能计算和高端移动处理器的前沿节点产能建设。该细分市场预计 2027 年增长 18.1%，2028 年增长 13.6%，达到 1047 亿美元，因为行业正迈向 2nm 全环绕栅级（GAA）节点的大规模量产。

存储相关设备支出受 HBM 需求、先进 DRAM 节点迁移和 NAND 技术转型推动，预计将在 2028 年前显著扩张。DRAM 设备销售额预计 2026 年增长 39.0%至 388 亿美元，随后 2027 年增长 27.4%，2028 年增长 15.0%，达到 569 亿美元。NAND 设备销售额预计 2026 年增长 30.7%至 139 亿美元，2027 年再增长 31.1%，2028 年增长 14.5%，达到 208 亿美元，这得益于 3D NAND 层数迁移和更高密度架构投资。

半导体设备销售额（按地区划分）

中国大陆、中国台湾和韩国预计将在 2028 年前继续保持设备支出前三名的地位。中国大陆预计在预测期内维持领先地位，但 2026 年增速预计将放缓，因近年来投资水平已处于高位。

（来自：SEMI 中国）

SEMI 与 GNC 联合发布半导体玻璃核心基板市场与发展趋势最新报告

美国加州时间 2026 年 5 月 27 日，SEMI 发布与 Global Net Corp. (GNC) 联合编制的聚焦玻璃核心基板市场及趋势的全新行业研究报告。《玻璃核心基板市场与发展趋势报告》(Glass Core Substrate Market and Development Trends Report) 审视了玻璃核心基板这一新兴市场——作为潜在的下一代封装技术，随着人工智能 (AI) 和高性能计算 (HPC) 推动对更大、更先进半导体封装的需求，该技术正受到越来越多的关注。

SEMI 高级总监 Clark Tseng 表示：“随着芯片制造商寻求超越传统器件微缩的新途径以提升系统性能，先进封装已成为关键的创新领域。玻璃核心基板正被评估为未来高端封装的可能解决方案之一，因为与传统封装基板材料相比，它可能有助于支持更大的封装尺寸、更精细的互连以及更优异的尺寸稳定性。这份新报告帮助行业了解玻璃核心基板在封装技术下一阶段可能扮演的角色，以及实现更广泛采用必须应对的挑战”。

该报告指出，随着企业为先进封装的下一阶段做准备，围绕玻璃核心基板领域的行业活动和投资正日益增加——报告以独立视角分析了技术的市场潜力、发展现状、主要参与者以及商业化进程中尚存的障碍。在其市场发展情景下，玻璃核心基板预计将于 2028 年左右在部分高性能应用领域率先启动，并随时间推移逐步应用于更大、更复杂的封装架构。基于乐观、基准和保守三种发展情景的平均值，报告预测 2028 年至 2040 年的复合年增长率 (CAGR) 为 67.2%。报告还梳理了日益活跃的全球研发生态系统，亚洲、北美和欧洲的企业及研究机构均在推进玻璃核心基板技术的发展。

(来自：SEMI 中国)